

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2026-064

芯原微电子(上海)股份有限公司 关于首次回购股份暨回购股份方案实施 完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026/10/30
回购方案实施期限	2026年10月28日至2027年10月27日
回购总金额	2,580.00万元至3,000.00万元
回购价格上限	20.90元/股
回购用途	☒ 减少注册资本 ☐ 用于员工激励计划股权激励 ☐ 用于转换上市公司可转债 ☐ 为维护上市公司价值及股东权益
当前回购股数	290,451股
实际回购股数占总股本比例	0.0552%
当前回购金额	28,702,368.11元
当前回购均价	98.23元/股=98.00元/股

一、回购实施情况和回购方案内容

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励,回购价格不超过200元/股(含),回购资金总额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含);回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2026年10月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-063)。

二、回购实施情况

(一)2026年10月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份290,451股,占公司总股本的比例为0.0552%,回购成交的最高价为99.00元/股,最低价为98.23元/股,支付的资金总额为人民币28,702,368.11元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(二)截至2026年10月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份290,451股,占公司总股本的比例为0.0552%,回购成交的最高价为99.00元/股,最低价98.23元/股,支付的资金总额为人民币28,702,368.11元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司本次股份回购已达到回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限,本次回购方案实施完毕。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额经董事会审议通过的回购方案、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)公司本次回购股份使用的资金均为公司自有资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司股权结构发生变化,回购后公司的股权结构分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

截至本公告披露日,公司的董事、高级管理人员在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。公司的控股股东及实际控制人,不存在控股股东买卖公司股票的情况。

四、股份变动

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股股份	-	-	-	-
无限售条件流通股股份	525,915,273	100.00	525,915,273	100.00
其中:回购专用证券账户	287,000	0.05	577,451	0.11
股份总数	525,915,273	100.00	525,915,273	100.00

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计计划回购公司股份290,451股,本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,并在公司公告披露股份回购实施结果公告日之后的三年内予以注销;若公司本次回购的股份未能按上述三年内注销完毕,公司将依法履行减少注册资本的义务,未购计划股份将被注销。如国家对相关政策法规进行调整,则本次回购方案按调整后的政策执行。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会、股东会表决权,利润分配、公积金转增股本、认股期权和可转换公司债券等权利。

后续公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会
2026年10月31日

证券代码:688521 证券简称:芯原股份

芯原微电子(上海)股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司监事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,317,266,720.74	2.85	3,180,806,116.42	41.08
利润总额	-253,108,067.95	不适用	-890,059,281.34	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-257,124,171.19	不适用	-899,249,186.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-262,348,176.86	不适用	-884,194,014.36	不适用
经营活动归属于上市公司股东的净利润	-149,512,459.03	不适用	-572,046,522.74	不适用
经营活动EBITDA(息税折旧及摊销前利润)	-49,315,801.26	-191.65	-271,775,701.77	不适用
经营活动EBITDA(息税折旧及摊销前利润)占营业收入比例	500,922,586.17	不适用	1,126,827,474.70	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.49	不适用	-1.65	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.49	不适用	-1.65	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.05	减少0.36个百分点	-28.14	减少14.96个百分点
研发投入合计	466,405,382.26	32.96	1,407,388,152.44	42.06
研发投入占营业收入的比例(%)	35.41	增加18.02个百分点	44.25	增加6.37个百分点
总资产	9,547,403,552.49		7,717,537,679.75	23.71
归属于上市公司股东的所有者权益	2,758,090,513.13		3,417,506,484.87	-19.30

注1:上表部分财务数据上年同期为负值,增减变动为“不适用”。

注2:“本报告期”指本报告期初至本报告期末3个月期间,下同。

注3:EBITDA(息税折旧及摊销前利润)=净利润+财务费用利息支出+所得税费用+折旧+摊销。

经调整后归属于上市公司股东的净利润,经调整后EBITDA(息税折旧及摊销前利润)调整项目均主要包括:①报告期内股份支付费用;②报告期内公司收购事项产生的非经常性或非现金性费用。

1.公司在手订单及新签订单情况

截至2026年9月末,公司在手订单金额达到185.69亿元,较去年同期提升265.90%;较二季度末进一步提升49.16%,且已连续12个季度保持高位。截至2026年9月末的在手订单中,量产服务业务订单150亿元,量产服务业务的规模效应显著,订单的持续转化将为公司未来盈利能力逐步提升奠定坚实基础。截至2026年9月末的在手订单中,超过81%为数据处理器领域订单且主要来自AI

ASIC。

2.研发投入情况

公司持续多年对半导体技术进行布局研发,在这个过程中,相关的研发投入通常会被费用化。随着高毛利率的半导体IP授权业务、可规模化量产服务业务持续扩张,公司毛利同步提升,毛利增速将高于研发费用增速,公司经调整后研发费用占毛利比重在合理下降,2026年第三季度经调整后研发费用占毛利比重较第二季度环比下降约8个百分点,预计2026年下半年环比、2026年全年较2025年全年同比,经调整后研发费用占毛利比重都将保持下降趋势,充分印证公司盈利化改革持续有效。

3.公司未来盈利展望

随着公司持续商业模式下的规模效应与经营杠杆逐步体现,公司盈利预期预计将稳步提升;公司预计2026年下半年实现经调整(非经常性或非现金性费用除外)后EBITDA(息税折旧及摊销前利润)转正,2027年实现全年经调整(非经常性或非现金性费用除外)后归属于上市公司股东的净利润转正。

上述经营目标是公司基于所属行业、公司的发展现状及趋势所做出的判断,可能受到宏观经济环境、市场情况、公司业务状况等多种因素影响,请广大投资者理性投资,注意风险。

注:1.不适用

注:2.不适用

注:3.不适用

注:4.不适用

注:5.不适用

注:6.不适用

注:7.不适用

注:8.不适用

注:9.不适用

注:10.不适用

注:11.不适用

注:12.不适用

注:13.不适用

注:14.不适用

注:15.不适用

注:16.不适用

注:17.不适用

注:18.不适用

注:19.不适用

注:20.不适用

注:21.不适用

注:22.不适用

注:23.不适用

注:24.不适用

注:25.不适用

注:26.不适用

注:27.不适用

注:28.不适用

注:29.不适用

注:30.不适用

注:31.不适用

注:32.不适用

注:33.不适用

注:34.不适用

注:35.不适用

注:36.不适用

注:37.不适用

注:38.不适用

注:39.不适用

注:40.不适用

注:41.不适用

注:42.不适用

注:43.不适用

注:44.不适用

注:45.不适用

注:46.不适用

注:47.不适用

注:48.不适用

注:49.不适用

注:50.不适用

注:51.不适用

注:52.不适用

注:53.不适用

注:54.不适用

注:55.不适用

注:56.不适用

注:57.不适用

注:58.不适用

注:59.不适用

注:60.不适用

注:61.不适用

注:62.不适用

注:63.不适用

注:64.不适用

注:65.不适用

注:66.不适用

注:67.不适用

注:68.不适用

注:69.不适用

注:70.不适用

注:71.不适用

注:72.不适用

注:73.不适用

注:74.不适用

注:75.不适用

注:76.不适用

注:77.不适用

注:78.不适用

注:79.不适用

注:80.不适用

注:81.不适用

注:82.不适用

注:83.不适用

注:84.不适用

注:85.不适用

注:86.不适用

注:87.不适用

注:88.不适用

注:89.不适用

注:90.不适用

注:91.不适用

注:92.不适用

注:93.不适用

注:94.不适用

注:95.不适用

注:96.不适用

注:97.不适用

注:98.不适用

注:99.不适用

注:100.不适用

注:101.不适用

注:102.不适用

注:103.不适用

注:104.不适用

注:105.不适用

公司2026年第三季度营业收入延续了第二季度环比增长的趋势,2026年第三季度实现营业收入13.17亿元,环比增长28.16%,在去年同期历史新高基础上继续增长,再创历史新高。

图:公司近期单季度营业收入变化情况



从各类业务具体表现来看,公司2026年第三季度实现设计服务收入3.57亿元,环比增长127.48%;实现量产服务收入7.36亿元,环比增长5.78%;实现IP授权使用收入1.90亿元,环比增长27.34%;实现IP特授权使用收入0.34亿元,环比增长37.75%。

图:2026年第三季度营业收入(按业务类别)构成情况

公司2026年第三季度营业收入(按业务类别)构成情况:设计服务收入3.57亿元,占比27.1%;量产服务收入7.36亿元,占比55.9%;IP授权使用收入1.90亿元,占比14.5%;IP特授权使用收入0.34亿元,占比2.5%。

3.公司2026年前三季度经营业绩分析



公司2026年前三季度实现营业收入31.81亿元,同比增长41.08%,其中芯片定制解决方案服务收入(包括设计服务收入、量产服务收入)占比基本持平。

图:2026年前三季度营业收入(按业务类别)构成情况

2026年前三季度,公司实现境内销售收入23.01亿元,占营业收入比重为72.35%。2026年前三季度,公司来自系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商和年企等客户群体的收入为8.99亿元,占营业收入比重约三成。受下游市场需求带动,2026年前三季度公司来自数据处理器领域的收入为13.84亿元,占营业收入比重为43.52%,占比同比提升10.38个百分点。

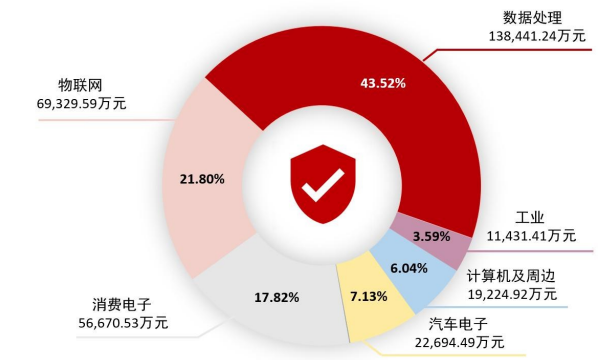


图:2026年前三季度营业收入(按应用领域划分)构成情况

2026年前三季度,公司半导体IP授权使用新增客户数量22家,截至报告期末累计半导体IP授权服务客户总数达490家;芯片定制解决方案服务新增客户数量28家,截至报告期末累计芯片定制解决方案服务客户总数达380家。

●半导体IP授权使用

2026年前三季度,公司实现IP授权使用收入4.83亿元,同比基本持平;实现IP特授权使用收入0.90亿元,同比增长10.18%。

在原有的核心处理器IP相关业务收入中,图形处理IP、神经网络处理IP和视觉处理IP收入占比较高,这三类IP在2026年前三季度半导体IP授权服务收入(包括IP授权使用收入、IP特授权使用收入)中占比合计约60%。上述IP已获得国内众多知名企业的广泛采用,在各应用领域发挥了重要作用。

●芯片定制解决方案服务

2026年前三季度,公司实现芯片设计服务收入7.07亿元,同比增长6.97%,其中28nm及以下工艺节点收入占比97.39%,14nm及以下工艺节点收入占比70.90%,7nm及以下工艺节点收入占比55.32%。截至报告期末,公司在执行芯片设计项目110个,其中28nm及以下工艺节点的项目数量占比为63.64%,14nm及以下工艺节点的项目数量占比为34.55%,7nm及以下工艺节点的项目数量占比为26.30%。

2026年前三季度,公司与AI算力相关的设备销售收入占比约为51%。

2026年前三季度,公司实现量产服务收入18.98亿元,同比增长86.80%,前三季度公司已超25年营业收入水平;2026年前三季度,为公司提供量产服务的项目数量119款,均来自公司自身设计服务项目,另有65个芯片设计项目待量产。

4.盈利分析

(1)毛利和利润情况

2026年前三季度,公司实现综合毛利(即毛利)9.60亿元,同比提升21.81%。公司2026年前三季度综合毛利率30.18%,较去年同期下降4.77个百分点,主要由于收入结构变化等因素导致。基于公司独特的商业模式,公司可提供芯片定制解决方案服务过程中,依托于公司拥有的SoC设计及验证、系统架构设计、软件架构及开发、系统测试、项目管理等全流程人才储备,前期为客户提供芯片设计服务,后期根据协议约定完成量产服务。在量产服务中,公司仅需以相对稳定的量产管理团队投入日益增长的量产项目,无需随量产服务规模增长线性扩充人员,体现出公司可规模化商业模式的特点。因此,综合毛利率并非绝对公司盈利能力的唯一指标,虽然公司量产服务毛利率相对半导体IP授权服务较高,但量产服务产生的毛利大部分可贡献于净利润。

2026年前三季度,公司经调整后归属于上市公司股东的净利润为-5.72亿元;公司经调整后EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为-2.72亿元。

(2)未来盈利展望

公司主营业务具备显著的规模效应与经营杠杆,收入规模的持续扩张可有效转化为盈利提升,带动公司盈利能力稳步提升。同时,公司依托成熟的研究团队与研发资源储备,持续加大AI研发工具投入,积极推动AI技术在研发全流程中的应用赋能,进一步提升研发产出效能,推动订单转化节奏加快,研发资源可高效投入项目研发,为业务规模扩张与盈利水平提升提供支撑。随着公司新签订单不断增长并持续转化为营业收入,公司持续商业模式下的规模效应与经营杠杆将逐步得以体现。

①研发费用与收入比重合理下降

公司将持续坚持“轻资产、高研发”的发展战略,坚持高研发投入以打造竞争壁垒,保证公司在半导体IP授权和芯片定制领域具备领先的芯片设计和技术研发实力。公司量产服务业务具备突出的规模化效应,量产服务仅需相对稳定的量产服务团队即可支撑不断扩大的业务体量,该业务产生的毛利绝大部分可直接转化为净利润;随着量产服务业务订单持续落地,业务规模快速扩张,公司收入增速将高于研发费用增速,带动研发费用占收入比重呈合理下降趋势;2026年第三季度经调整后,非经常性非现金性费用除外,下同)研发费用占收入比重较第二季度环比下降约8个百分点,预计2026年下半年较2026年上半年较2025年全年较2025年全年同比,经调整后研发费用占收入比重都将保持下降趋势。该指标下降并非缩减研发投入,而是业务规模增长带来的结果。

②研发费用占毛利比重合理下降

公司持续多年对半导体技术进行布局研发,在这个过程中,相关的研发投入通常会被费用化。随着高毛利率的半导体IP授权业务、可规模化量产服务业务持续扩张,公司毛利同步提升,毛利增速将高于研发费用增速,公司经调整后研发费用占毛利比重在合理下降,2026年第三季度经调整后研发费用占毛利比重较第二季度环比下降约8个百分点,预计2026年下半年环比、2026年全年较2025年全年同比,经调整后研发费用占毛利比重都将保持下降趋势,充分印证公司盈利化改革持续有效。

③未来盈利展望

随着公司持续商业模式下的规模效应与经营杠杆逐步体现,公司盈利预期预计将稳步提升;公司预计2026年下半年实现经调整(非经常性或非现金性费用除外)后EBITDA(息税折旧及摊销前利润)转正,2027年实现全年经调整(非经常性或非现金性费用除外)后归属于上市公司股东的净利润转正。

上述经营目标是公司基于所属行业、公司的发展现状及趋势所做出的判断,可能受到宏观经济环境、市场情况、公司业务状况等多种因素影响,请广大投资者理性投资,注意风险。

注:1.不适用

注:2.不适用

注:3.不适用

注:4.不适用

注:5.不适用

注:6.不适用

注:7.不适用

注:8.不适用

注:9.不适用

注:10.不适用

注:11.不适用

注:12.不适用

注:13.不适用

注:14.不适用

注:15.不适用

注:16.不适用

注:17.不适用

注:18.不适用

注:19.不适用

注:20.不适用